



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20110603001

2011 年 6 月 14 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

PWR MSOPパッケージ 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイヤ変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただいたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site	☐ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -		
変更内容	PWR MSOP パッケージ 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイヤ変更 現行 : Au(金)線 変更後 : Cu(銅)線			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	9月下旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☒ 計画	☐ 終了		
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容：弊社 PWR(パワーマネジメント) MSOP パッケージ 一部製品について、現行 Au(金)線ボンディングワイヤを使用して製造していますが、機械/電気的特性の向上, 同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為に、Cu(銅)線ボンディングワイヤに変更します。ワイヤ径の変更については下記を参照下さい。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
ボンディングワイヤ	Au(金)線	Cu(銅)線

現行 Au(金)線 ワイヤ径	変更後 Cu(銅)線 ワイヤ径
1.0 Mils	1.0 Mils
1.3 Mils	1.0 Mils
2.0 Mils	2.0 Mils

理由：機械/電気的特性の向上, 同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

対象製品リスト

対象製品名				
BQ24091DGQR	TPS51100DGQG4	TPS62040DGQG4	TPS65552ADGQR	UCC27424DGN4
HPA00356DGQR	TPS51100DGQR	TPS62040DGQR	TPS65552ADGQRG4	UCC27424DGNR
HPA00570DGQR	TPS51100DGQRG4	TPS62040DGQRG4	UCC27323DGN	UCC27424DGNRG4
SNO408089DGQR	TPS54040DGQR	TPS62042DGQ	UCC27323DGN4	UCC37323DGN
SNO408089DGQRG4	TPS54060DGQR	TPS62042DGQG4	UCC27323DGNR	UCC37323DGN4
SNO805015DGQR	TPS54140DGQR	TPS62042DGQR	UCC27323DGNRG4	UCC37323DGNR
SNO805015DGQRG4	TPS54160DGQR	TPS62042DGQRG4	UCC27324DGN	UCC37323DGNRG4
TPS2060DGN4	TPS54160DGQRG4	TPS62043DGQ	UCC27324DGN4	UCC37324DGN
TPS2065DGN-1G4	TPS62020DGQ	TPS62043DGQG4	UCC27324DGNR	UCC37324DGN4
TPS2065DGNR-1G4	TPS62020DGQG4	TPS62043DGQR	UCC27324DGNRG4	UCC37324DGNR
TPS40007DGQ	TPS62020DGQR	TPS62043DGQRG4	UCC27325DGN	UCC37324DGNRG4
TPS40007DGQG4	TPS62020DGQRG4	TPS62044DGQ	UCC27325DGN4	UCC37325DGN
TPS40007DGQR	TPS62021DGQR	TPS62044DGQG4	UCC27325DGNR	UCC37325DGN4
TPS40007DGQRG4	TPS62021DGQRG4	TPS62044DGQR	UCC27325DGNRG4	UCC37325DGNR
TPS40009DGQ	TPS62026DGQ	TPS62044DGQRG4	UCC27423DGN	UCC37325DGNRG4
TPS40009DGQG4	TPS62026DGQG4	TPS62046DGQ	UCC27423DGN4	
TPS40009DGQR	TPS62026DGQR	TPS62046DGQG4	UCC27423DGNR	
TPS40009DGQRG4	TPS62026DGQRG4	TPS62046DGQR	UCC27423DGNRG4	
TPS51100DGQ	TPS62040DGQ	TPS62046DGQRG4	UCC27424DGN	

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2011 年 2 月	終了	2011 年 6 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS40009DGQ	-	-	
Assembly Site:	ASESH	Package/Code/Pins:	MSOP/DGQ/10	
Mount Compound:	EY1000063	Mold Compound:	EN2000515	
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	NiPdAuAg, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Steady-state Life Test	125C, 168, 500, 1000 Hrs	26	26	26
Electrical Characterization	Full Temp & Voltage range	30	-	-
Assembly MQ	Per Assembly Site spec.	per spec	-	-
Yield Evaluation	FT yield & bin summary	per spec	-	-
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2011 年 2 月	終了	2011 年 6 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS62040DGQ	-	-	
Assembly Site:	ASESH	Package/Code/Pins:	MSOP/DGQ/10	
Mount Compound:	EY1000063	Mold Compound:	EN2000515	
Bond Wire:	1.0mil, Cu	Lead frame (Finish, Base):	NiPdAuAg, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Electrical Char	Full Temp & Voltage range	30	-	-
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77	77	77
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Assembly MQ	Per Assembly Site spec.	per spec	per spec	per spec
X-ray	top side only	5	5	5
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	12	12
Yield Evaluation	FT yield & bin summary (TITL)	per spec	-	-
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2011 年 2 月	終了	2011 年 6 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS2066DGN	-	-	
Assembly Site:	ASESH	Package/Code/Pins:	MSOP/DGN/8	
Mount Compound:	EY1000063	Mold Compound:	EN2000515	
Bond Wire:	2.0 Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	NiPdAuAg, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	-	-
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	-	-
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2011 年 2 月	終了	2011 年 6 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS51100DGQ	-	-	
Assembly Site:	ASESH	Package/Code/Pins:	MSOP/DCQ/10	
Mount Compound:	EY1000063	Mold Compound:	EN2000515	
Bond Wire:	1.3 Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	NiPdAuAg, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Electrical Characterization	-	30	-	-
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	-	-
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	-	-
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C				